

無鉛はんだ・グリーン調達

無鉛はんだの推進

無鉛はんだの開発を進めており、鉛はんだ削減方針にしたがい、製品全体から鉛はんだを全廃していきます。

鉛はんだ削減方針

- 2000年10月から全LSI製品の無鉛はんだ対応完了
- 2001年12月から全プリント板ユニット枚数の50%を鉛はんだ廃止
- 2002年12月末以降は全製品から鉛はんだを全廃

技術開発

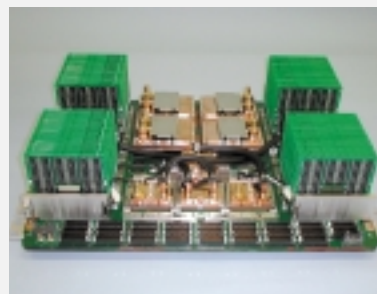
富士通研究所と共同で、高信頼度の無鉛はんだ技術を開発し、1999年10月に発表したグローバルサーバの新機種「GS8900」の主要プリント板ユニットに採用しました。

開発項目

- Sn - Ag系はんだの材料および接合技術の開発
- Sn - Bi共晶 + Ag系はんだの材料および接合技術の開発
- 上記2種類の無鉛はんだを使用し、融点の異なる複数のはんだによる温度階層を利用した製造プロセスの開発



グローバルサーバ「GS8900」



GS8900プリント板ユニット
(無鉛はんだ使用)

グリーン調達の推進

1998年度から、ISO14001認証取得工場の調達先に対し、環境法規に関する事業活動や環境問題の取り組み調査を開始しています。1999年度は、開発・設計の拠点である川崎工場の調達先49社に対する追加調査を新たに実施しました(累計320社)。

また、1998年度に調査を行った271社分をデータベース化し、ホームページを通じて開発・設計部門に情報提供を行い、グリーン製品の開発に活用しました。